

不良の特定にお困りの、各種パッケージ・高多層基板の検査工程のみなさまへ



私たち EORIC は、皆さまのお悩みを解決するために、**高機能 CAD ビューワー『AZSA-HS View』** ならびに**発光点/TDR 解析ソリューション（オプション）**の販売を開始いたします。

◆『AZSA-HS View』とは？

CAD ビューワー上で、各種検査装置の結果と CAD データをリンクさせて、基板の不良個所を瞬時にピンポイントで見つけるソフトウェアです。

これまで検査方法は、パッケージや高多層基板の製造途中における AOI 検査や完成後の破壊検査が主流でした。手間と時間をかけて様々な検査を繰り返し、ようやく破損箇所を特定しても、本質的な真因にたどり着くことは困難でした。

お手持ちの検査装置に『**AZSA-HS View**』を搭載する。

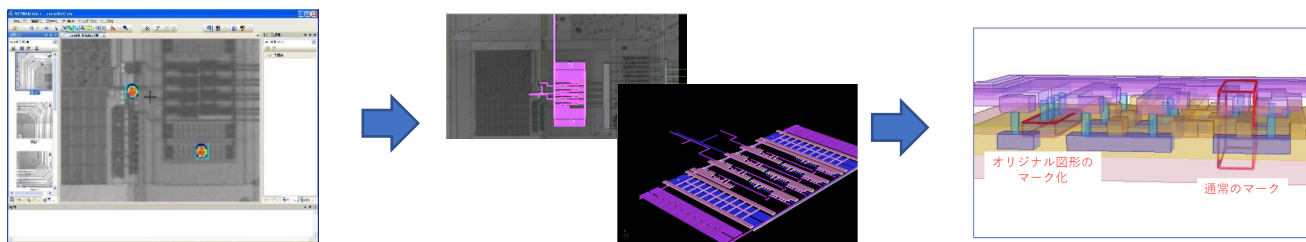
それだけで破壊検査をすることなく、たった**30分^{*1}**で、不良個所をピンポイントで見つけ出し、解析の成功率は**95%^{*1}**まで飛躍的に向上します。

^{*1}: 過去ソフト実績より

◆『AZSA-HS View』の仕組み



各種解析装置の結果と CAD データをリンクさせることにより、どこに不良があるのか、3D のピンポイントで特定することが可能です。



< 検査結果を確認 >

< 関連性のある配線を表示 >

< 3D で階層も特定 >

- 01 : PC に『AZSA-HS View』をインストールする。
- 02 : エミッション顕微鏡や、TDR 解析装置から検査結果をアウトプットする。
- 03 : 『AZSA-HS View』にて、設計 CAD データならびに上記検査結果を読み込む。
- 04 : 両データを照合し、検査結果に対してトレースを実行し、関連性のある回路パターンを明確化する。
- 05 : 不良原因の可能性がある回路を特定し、3D で表示する。

◆『AZSA-HS View』シリーズでできること

- ・『AZSA-HS View』 : CAD Viewer 機能
- ・発光点解析ソリューション : 発光点解析結果を AZSA 上でトレース、解析する機能
- ・TDR 解析ソリューション : TDR 解析結果を AZSA 上でトレース、解析する機能

◆未来の不良を究極まで低減する

蓄積した解析結果から不良の傾向を検証分析する。

→回路デザインの修正、工程の見直しなど、開発・設計・製造に反映する。

→不良発生起因を低減する。

***常に根拠ある改善をし続けることで、歩留まりが飛躍的に向上します。**

◆検査装置（例）

Hitachi High-Tech

- ・Regulus Series
- ・NP6800/4000
- ・NX Series/MI4050

**thermo
scientific**

- ・Apreo/Prisma
- ・Helios Series/Scios
- ・ELITE



E O R I C
Edge Optics Research Institute Co.,Ltd

◆お問い合わせ

株式会社 EORIC 営業 G 金森 竜弥

Mail : t-kanamori@eoric.jp TEL : 050-5374-4657